

S2C-SMT 3.50/20/180G 3.5SN BK RL

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Produktbild

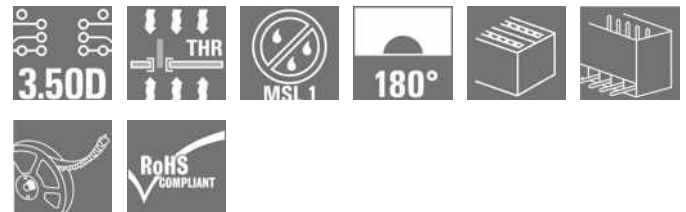


Abbildung ähnlich

Hochtemperaturfeste Stiftleiste

- fingersicher
- steckbar zu Buchsenstecker B2CF 3.50 PUSH IN
- Steckrichtung senkrecht oder parallel zur Leiterplatte (180° / 90°)
- Gehäusevarianten geschlossen (G) und mit Lötflansch (LF)
- Verpackt im Karton (BX) oder antistatisch im Tape-on-Reel (RL)
- Für Reflow- und Wellenlötanwendungen geeignet
- Stiftlänge wahlweise 1,5 mm oder 3,5 mm

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 20, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, schwarz, Tape
Best.-Nr.	1358830000
Typ	S2C-SMT 3.50/20/180G 3.5SN BK RL
GTIN (EAN)	4050118161786
VPE	175 Stück
Produkt-Kennzahlen	IEC: 200 V / 13.4 A UL: 150 V / 10 A
Verpackung	Tape

S2C-SMT 3.50/20/180G 3.5SN BK RL

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	10,8 mm	Tiefe (inch)	0,425 inch
Höhe	17,7 mm	Höhe (inch)	0,697 inch
Höhe niedrigstbauend	14,2 mm	Breite	36,4 mm
Breite (inch)	1,433 inch	Nettogewicht	5,549 g

Temperaturen

Betriebstemperatur, min.	-50 °C	Betriebstemperatur, max.	120 °C
--------------------------	--------	--------------------------	--------

Systemkennwerte

Produktfamilie	OMNIMATE Signal - Serie B2C/S2C 3.50 - 2-reihig	Anschlussart	Platinenanschluss
Montage auf der Leiterplatte	THT/THR-Lötanschluss	Raster in mm (P)	3,5 mm
Raster in Zoll (P)	0,138 inch	Abgangswinkel	180°
Polzahl	20	Anzahl Lötstifte pro Pol	1
Lötstiftlänge (l)	3,5 mm	Lötstiftlänge-Toleranz	0 / -0,3 mm
Lötstift-Abmessungen	d = 1,0 mm, oktogonal	Lötstift-Abmessungen=d Toleranz	+0,01 / -0,03 mm
Bestückungsloch-Durchmesser (D)	1,3 mm	Bestückungsloch-Durchmesser Toleranz (D)	+ 0,1 mm
Außendurchmesser Lötauge	2,1 mm	Schablonenloch Durchmesser	1,9 mm
L1 in mm	31,5 mm	L1 in Zoll	1,24 inch
Anzahl Reihen	1	Polreihenzahl	2
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106	fingers. ungest./ handrückens. gesteckt	Berührungsschutz nach DIN VDE 0470	IP 20 gesteckt/ IP 10 ungesteckt
Kodierbar	Ja	Steckkraft/Pol, max.	3,5 N
Ziehkraft/Pol, max.	3,5 N		

Werkstoffdaten

Isolierstoff	LCP GF	Farbe	schwarz
Farbtabelle (ähnlich)	RAL 9011	Isolierstoffgruppe	IIIb
Kriechstromfestigkeit (CTI)	≥ 175	Moisture Level (MSL)	1
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Kontaktmaterial	Cu-Leg
Kontaktoberfläche	verzinkt	Schichtaufbau - Lötanschluss	1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matt
Schichtaufbau - Steckkontakt	1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matt	Lagertemperatur, min.	-40 °C
Lagertemperatur, max.	70 °C	Betriebstemperatur, min.	-50 °C
Betriebstemperatur, max.	120 °C	Temperaturbereich Montage, min.	-40 °C
Temperaturbereich Montage, max.	120 °C		

S2C-SMT 3.50/20/180G 3.5SN BK RL

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

Technische Daten

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com
13,4 A

Bemessungsspannung bei
Überspannungsk./Verschmutzungsgrad
II/2 200 V

Bemessungsspannung bei
Überspannungsk./Verschmutzungsgrad
III/3 80 V

Bemessungsstoßspannung bei
Überspannungsk./Verschmutzungsgrad
III/2 2,5 kV

Kurzzeitstromfestigkeit
3 x 1s mit 80 A

Bemessungsdaten nach IEC

geprüft nach Norm

IEC 60664-1, IEC 61984

Bemessungsstrom, min. Polzahl
(Tu=40°C)

12 A

Bemessungsspannung bei
Überspannungsk./Verschmutzungsgrad
III/2

160 V

Bemessungsstoßspannung bei
Überspannungsk./Verschmutzungsgrad
II/2

2,5 kV

Bemessungsstoßspannung bei
Überspannungsk./Verschmutzungsgrad
III/3

2,5 kV

Nennenden nach CSA

Institut (CSA)



Zertifikat-Nr. (CSA)

200039-1121690

Nennspannung (Use group B / CSA) 150 V

Nennspannung (Use group D / CSA) 150 V

Nennstrom (Use group C / CSA) 9,5 A

Hinweis zu den Zulassungswerten
Angaben sind
Maximalwerte, Details
siehe Zulassungs-
Zertifikat.

Nennspannung (Use group C / CSA) 50 V

Nennstrom (Use group B / CSA) 9,5 A

Nennstrom (Use group D / CSA) 9,5 A

Nennenden nach UL 1059

Institut (cURus)



Zertifikat-Nr. (cURus)

E60693

Nennspannung (Use group B / UL
1059) 150 V

Nennstrom (Use group B / UL 1059) 10 A

Hinweis zu den Zulassungswerten
Angaben sind
Maximalwerte, Details
siehe Zulassungs-
Zertifikat.

Nennspannung (Use group C / UL
1059) 50 V

Nennstrom (Use group C / UL 1059) 10 A

Verpackungen

Verpackung Tape VPE Länge 155 mm

VPE Breite 64 mm VPE Höhe 38 mm

Tapetiefe (T2) 19,8 mm Tapebreite (W) 56 mm

Tape-Taschentiefe (KO) 19,3 mm Tape-Taschenhöhe (AO) 11,1 mm

Tape-Taschenbreite (BO) 42 mm Tape-Taschenabstand (P1) 20 mm

Tape-Lochabstand (E) 1,75 mm Tape-Taschenabstand (F) 26,2 mm

Tape-Spulendurchmesser \varnothing (A) 330 mm Oberflächenwiderstand $R_s = 10^9 - 10^{12} \Omega$

Breite Pick & Place Pad (B_{PPP}) 10 mm Länge Pick & Place Pad (L_{PPP}) 15,6 mm

Durchmesser der Entnahmefläche (\varnothing
D_{max}) 9 mm Überstand 1 Pick & Place Pad (L_{O1 (PPP)}) 7,8 mm

Überstand 2 Pick & Place Pad (L_{O2 (PPP)}) 7,8 mm

Erstellungs-Datum 26. April 2023 16:55:06 MESZ

Katalogstand 14.04.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

S2C-SMT 3.50/20/180G 3.5SN BK RL

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Technische Daten

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637	ECLASS 9.0	27-44-04-02
ECLASS 9.1	27-44-04-02	ECLASS 10.0	27-44-04-02
ECLASS 11.0	27-46-02-01	ECLASS 12.0	27-46-02-01

Wichtiger Hinweis

IPC-Konformität	Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise	<ul style="list-style-type: none"> • Vergoldete Kontaktflächen auf Anfrage • Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl • Reihenabstand siehe Lochbilder • Zeichnungsangabe P = Raster • Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten. • Langzeitlagerung des Produkts mit einer durchschnittlichen Temperatur von 50 °C und einer durchschnittlichen Luftfeuchtigkeit von 70%, 36 Monate

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus)	E60693

S2C-SMT 3.50/20/180G 3.5SN BK RL

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Technische Daten

Downloads

Zulassung / Zertifikat /
Konformitätsdokument

[Declaration of the Manufacturer](#)

Engineering-Daten

[CAD data – STEP](#)

Produktänderungsmitteilung

[Changeover to ESD bags for "Tape on Reel" products](#)

[Umstellung auf ESD-Beutel bei „Tape on Reel“ Produkten](#)

Kataloge

[Catalogues in PDF-format](#)

Broschüren

[FL DRIVES EN](#)

[MB SMT EN](#)

[FL DRIVES DE](#)

[MB DEVICE MANUF. EN](#)

[FL BUILDING SAFETY EN](#)

[FL APPL LED LIGHTING EN](#)

[FLIndustr.CONTROLS EN](#)

[FL MACHINE SAFETY EN](#)

[FL HEATING ELECTR EN](#)

[FL APPL INVERTER EN](#)

[FL_BASE_STATION_EN](#)

[FL ELEVATOR EN](#)

[FL POWER SUPPLY EN](#)

[FL 72H SAMPLE SER EN](#)

[PO OMNIMATE EN](#)

[PO OMNIMATE EN](#)

Whitepaper surface mount technology

[Download Whitepaper](#)

S2C-SMT 3.50/20/180G 3.5SN BK RL

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

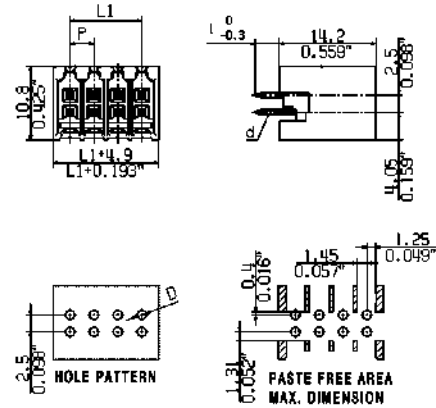
Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

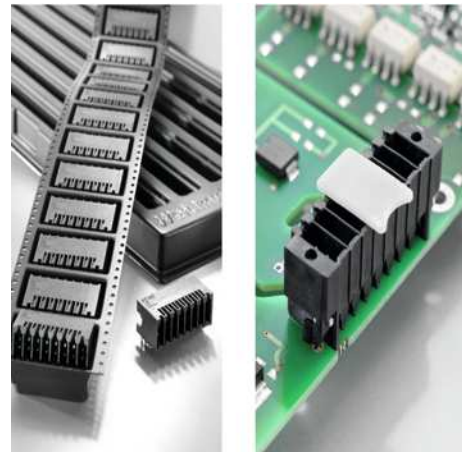
info@weidmueller.com

Zeichnungen

Maßbild



Produktvorteil



Optimiert für den SMT-Prozess
Sichere Board-to-Board-Verbindung

S2C-SMT 3.50/20/180G 3.5SN BK RL

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

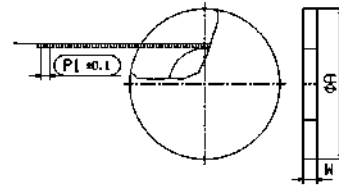
Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

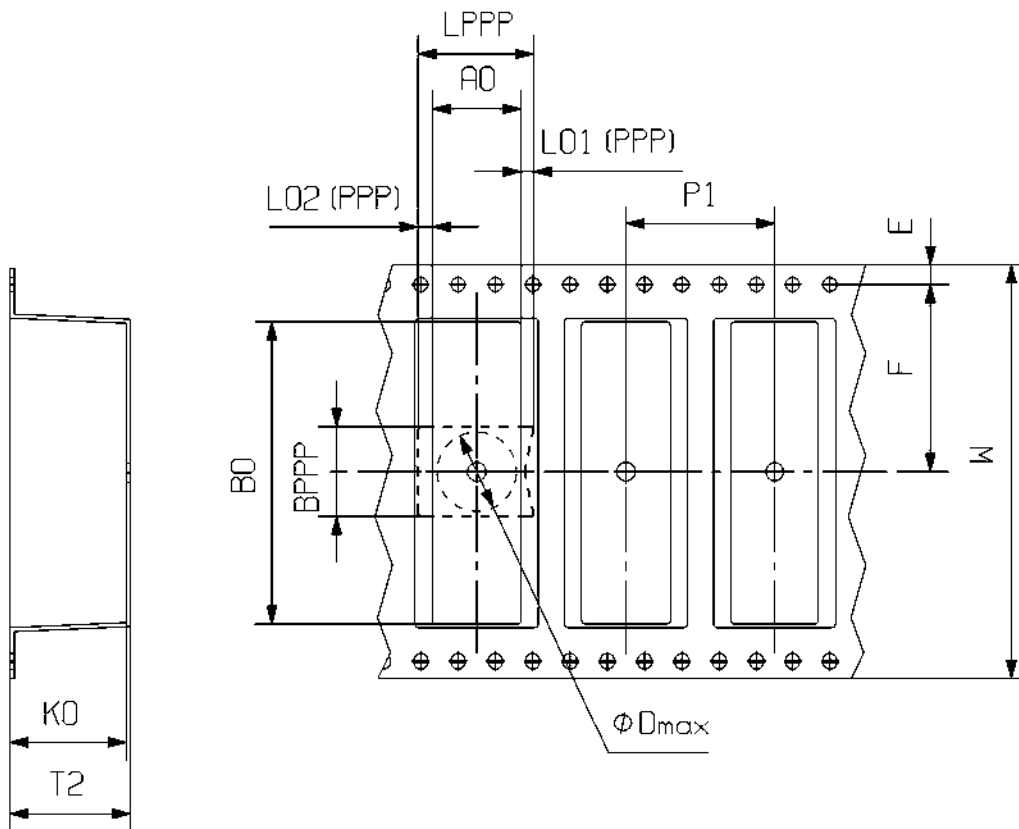
info@weidmueller.com

Zeichnungen

Maßbild



Maßbild

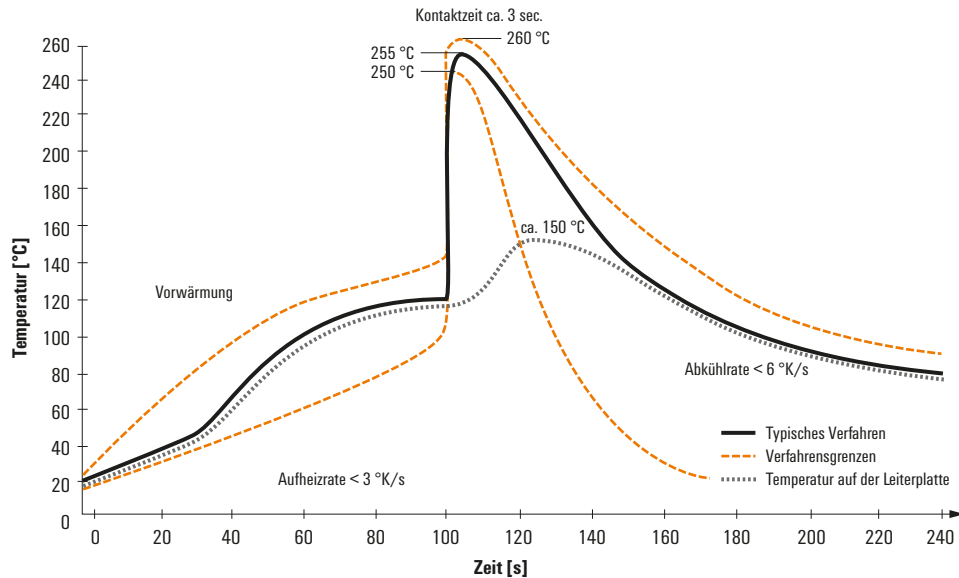


DIRECTION OF UNREELING →

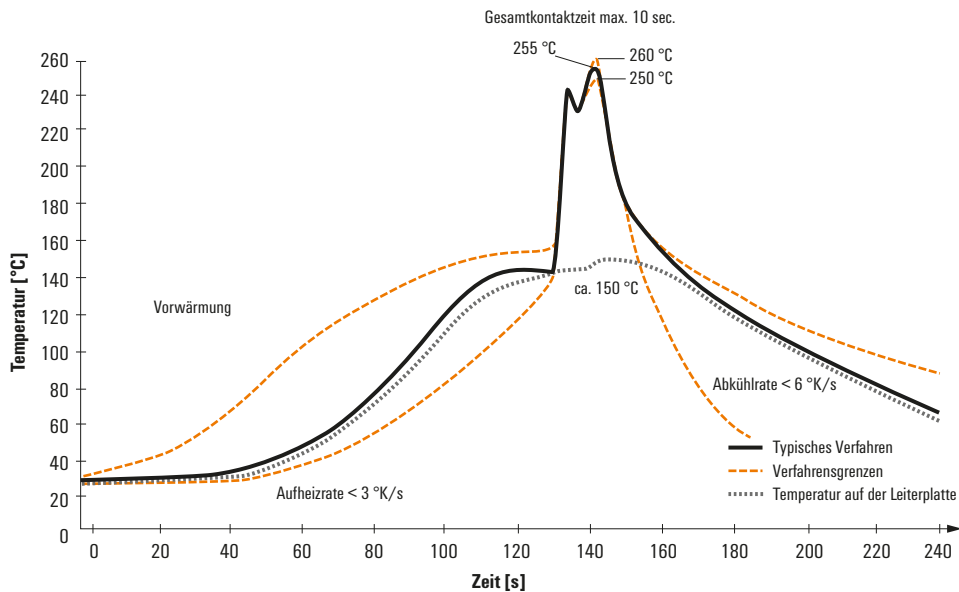
Empfohlene Wellen-Lötprofile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Einzelwelle:



Doppelwelle:



Wellen-Lötprofile

Bedrahtete Anschlüsselemente sind in Anlehnung an die Norm DIN EN 61760-1 zu verarbeiten. Anbei zwei Empfehlungen für praxisbezogene Wellenlötprofile, mit denen Leiterplattenanschlussklemmen und Steckverbinder von Weidmüller qualifiziert sind.

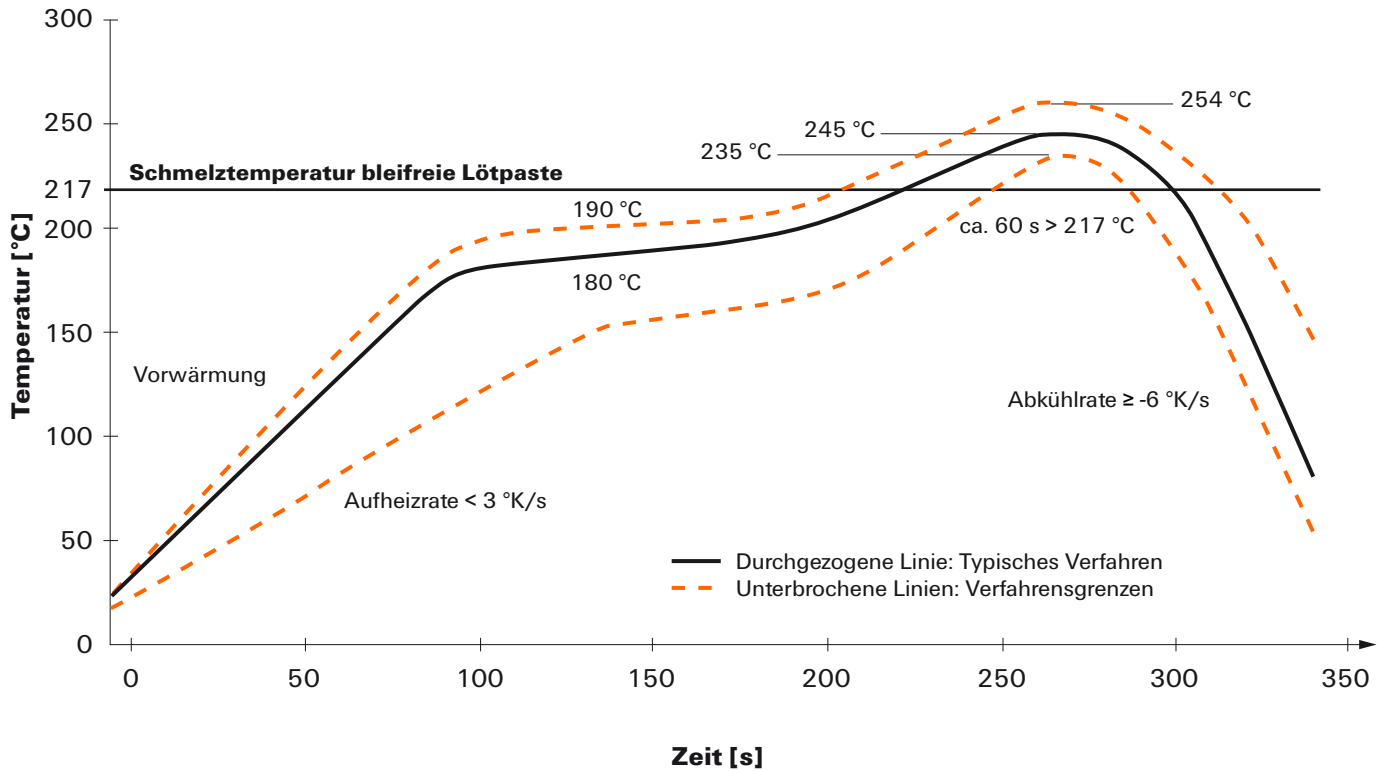
Bei der Wahl eines passenden Profils für Ihre Anwendung sind unter anderem folgende Faktoren zu beachten:

- Stärke der Leiterplatte
- Cu-Anteile in den Lagen
- Ein-/Beidseitige Bestückung
- Produktspektrum
- Aufheiz- und Abkühlrate

Die Einzel- und Doppelwelle zeigt jeweils den empfohlenen Verarbeitungsbereich inkl. der maximalen Löttemperatur von 260°C. In der Praxis liegt die maximale Löttemperatur sehr häufig weit unter dem o.g. Maximalprofil.

Empfohlenes Reflow-Lötprofil

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Reflow Lötprofil

Das ideale Temperaturprofil für die Surface Mount Technology (SMT) ist eine häufig gestellte Frage in der Produktionswelt. Eine eindeutige Antwort gibt es nicht. Der Temperatur-Zeit-Verlauf ist abhängig von den Verarbeitungseigenschaften der Lotpaste und den Belastungsgrenzen der Bauelemente.

Folgende Parameter sind zu berücksichtigen:

- Vorheizzeit
- Maximale Temperatur
- Zeit oberhalb des Pasten-Schmelzpunktes
- Abkühlzeit
- maximaler Aufheizgradient
- minimaler Abkühlgradient

Das von uns empfohlene Lötprofil beschreibt den typischen Verlauf sowie die Prozessgrenzen. In der Vorheizphase werden Platine und Bauelemente schonend vorgeheizt. Der Aufheizgradient beträgt $\leq +3$ K/s. Parallel dazu wird die Lotpaste ‚aktiviert‘. In der Zeit oberhalb der Schmelztemperatur 217 °C wird das Lot flüssig, verbindet die Bauelemente mit den Anschlüsse auf der Platine. Dabei wird die maximale Temperatur von 245 °C bis 254 °C zwischen 10 und 40 Sekunden gehalten. In der Abkühlzeit bei ≥ -6 K/s härtet das Lot aus. Platine und Bauelemente werden nicht zu rasch abgekühlt, um Spannungsrisse zu vermeiden.